Company Encyclopedia Ⅱ

NEXCOM（台湾本社） ▶ 会社概要 / 沿革

Message

1992 年に設立された NEXCOM International は、ハイエンドコンピューティングを実現し、インテリジェントなソリューションを構築するための信頼できるパートナーになることをお約束します。NEXCOM はその能力を統合し、IoT オートメーション、デジタルセキュリティ、スマートシティ向けプラットフォーム、車載用ソリューション、医療・ヘルスケアインフォマティクス、ネットワークの 6 つのグローバルビジネスを運営しています。NEXCOM は、IoT、ロボティクス、コネクテッドカー、インダストリー 4.0、産業用セキュリティなどの新興アプリケーションにおけるソリューションの提供を拡大し、カスタマイズサービス、グローバルロジスティック、ローカルアクセス、リアルタイムサポートの提供により、強力なサービスネットワークを構築しています。NEXCOM は、台湾、日本、中国、米国の子会社を運営し、お客様のご要望にお応えするとともに、各地域のグローバルパートナーとの緊密な連携を可能とします。

NEXCOM International Co., Ltd.
CEO & Chairman Clement Lin

NEXCOM
COMMITTED TO CUSTOMER SUCCESS

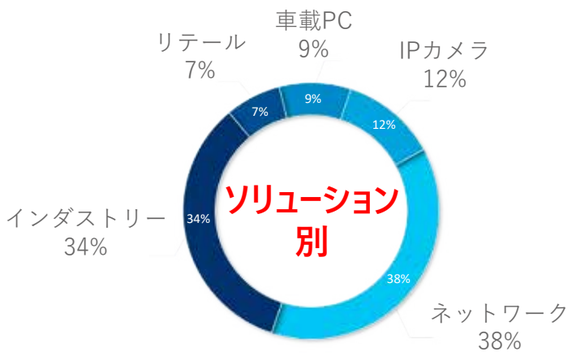
会社概要

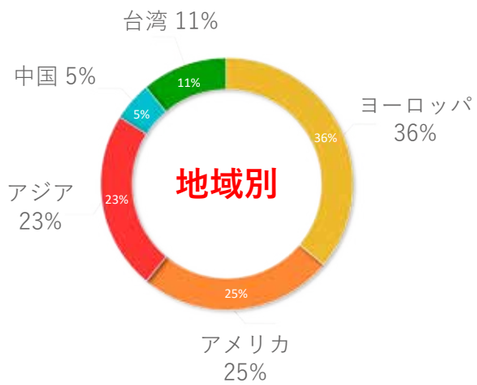
社名	Nexcom International Co., LTD
所在地	台湾235　新北市中和区中正路920号15F
代表者	CEO & Chairman:　林茂昌 (Clement Lin)
資本金	USD 43 Million（約 67億円）
売上高	USD184 Million（約285億円：2023年12月期）
創業	1992年11月
社員数	1200名
工場	
板橋工場	面積10,480㎡
華亜工場	面積 8,300㎡

NEXCOM International 沿革

1992年	11月14日 NEXCOM International設立
1994年	Intel 486 グラフィックワークステーション Next Step 486 販売
1995年	シングルボードコンピュータ PEAKシリーズ発売
1997年	コンパクトPCI MAXIシリーズ発売
	PICMG SBC＆ATXサーバボード発表
1998年	NEXCOMブランドネーム使用開始
1999年	イギリス、アメリカに現地法人設立　TUV ISO9001認証取得
2000年	ブレードサーバ Hi-Server309 発売　ネクスコム･ジャパン設立
2001年	中和に製造工場を開設　本社を三重から中和に移転
2002年	ブレードサーバ NexBlade HS318 が USAにて product of the year 受賞
2004年	ブレードサーバ HS416 が COMPUTEX台湾にて
	Best Choice of Taiwan IT Products 受賞
2005年	TUV ISO14001認証取得
2006年	北京に現地法人NEXCOM China設立
2007年	台湾にて株式上場（Gre Tai Securities Market 新漢8234）
2011年	台湾板橋に新工場を開設（中和工場を移転）　台湾本社新社屋へ移転
2018年	NexCOBOT 及び EMBUX を分社化、子会社 IAS を NexAIoT へ社名変更
	NEXCOM第２工場となる華亜スマートファクトリーを開設
2019年	IPカメラ事業部を GreenBase に分社化、DivioTec を吸収合併
2023年	NEXCOMグループ創立30周年

NEXCOMグループ ▶ 売上の内訳





NEXCOM JAPAN ▶ 会社概要 / 沿革

Message

ネクスコム・ジャパンは、2000 年 12 月に東京銀座に設立し、すでに 20 年以上の歴史を持ち、NEXCOM International 製各種産業用 PC、システム、ソリューション、ODM の販売及びサポートを担います。創業時より変わらない一貫したポリシーで日本のお客様を第一としたフレキシブルなサポートをタイムリーに展開いたします。熟練したスタッフによる国内でのアセンブリ、テスト、カスタマイズなど、台湾本社との太い連携により、お客様に安心して、高性能・高信頼性・低価格な製品をご提供いたします。プロジェクトのコンサルから販売、サポート、さらには不要になった際の廃棄まで、サステナブルに展開中です。産業用 FA PC・デジタルサイネージ・リテールキオスク・車載用 PC・ネットワーク機器・IP カメラに至るまで広範囲な製品を 1 台ずつ大切にお客様の元へお届けします。

Tokyo,Japan

NEXCOM

会社概要

社名	株式会社ネクスコム･ジャパン
所在地	〒108-0014 東京都港区芝4-11-5
	田町ハラビル9階 Tel:03-5419-7830
代表者	CEO:　Clement Lin
	President:　Peter Yang
	Vice President:　Tomoyuki Asaumi
資本金	4千万円
設立	2000年12月4日
生産拠点	同ビル2F
業務内容	ネクスコムインターナショナル社製
	各種産業用システムの販売及びサポート

NEXCOM Japan 沿革

2000年	東京都中央区銀座8丁目に事務所を設立
2001年	日本人スタッフによる運営開始
	ハイエンドマザーボード NEXシリーズ 販売開始
	ブレードサーバ Hi Server309 販売開始
2002年	コンパクトPCI Maxiシリーズ販売
2003年	ファンレスシステム EBS1563 販売開始
	ネットワークセキュリティ市場に参入
	ブレードサーバ Hi Server318 販売開始
2004年	日本電気株式会社向けサーバのODM
2005年	自動販売機向けマザーボード EBC569 25,000枚出荷
	NICE3100 販売開始/車載用PCの販売開始
2006年	NEXCOM International 社長 Peter Yang が
	ネクスコム･ジャパン社長に就任
2007年	福西電機株式会社と販売代理店契約
2008年	郵政案件 4th P-net向け PX500 24,000台出荷
	菱洋エレクトロ株式会社と販売代理店契約
2009年	デジタルサイネージ業界に参入
	NISE2000 使ってみてみてキャンペーン開始
	PBOXシリーズ Made in GINZA 販売開始
2010年	現在の東京都港区芝に移転(田町)
2011年	NEXCOM Express 創刊
2012年	NTTドコモとネクスコムM2Mソリューションセミナを開催
2013年	郵政案件 5th P-net向け NISE2300 13,000台出荷
	第一回ジャパンパートナーカンファレンス(JPC)を
	品川インターコンチネンタルホテルにて開催
	One Day Shipping サービス開始
2014年	第二回JPCを東京シャングリラホテルにて開催
	本社ビル2Fにアセンブリセンタと倉庫を増設
2015年	第三回JPC with 福西電機を
	大阪インターコンチネンタルホテルにて開催
2016年	日本語版 NEXCOM Express 創刊
	ワイヤレス事業に参入
2017年	Intel NEXCOM 製造業セミナを開催
	台湾本社にてMECHATROLINK協会(安川電機)とIoTセミナを開催
2018年	IPカメラ業界に参入
2019年	NexCOBOT製品 販売開始
2020年	郵政案件 6th P-net向け NISE505　27,000台出荷
	創業20周年記念式典開催
2021年	低価格設定 Value Model 販売開始

取り扱い製品カタログ

- 産業用ファンレスコンピュータ / IoTゲートウェイ
- スマートリテール･サイネージソリューション
- 車載コンピュータソリューション
- インテリジェントデジタルセキュリティ
- モーションコントロール＆ロボティクスソリューション
- ネットワーク&コミュニケーションソリューション
- NEXCOM Express Japan Edition

NEXCOM JAPAN ▶ ネクスコム･ジャパン22年の足跡

ネクスコム・ジャパン開設
プレスカンファレンス（2001 年 3 月）

ネクスコム・ジャパンの初めての
展示会出展ブース（2001 年 4 月）

ネクスコム・ジャパンチラシ
第一弾「NEXCOM 日本上陸！」

2000　銀座に誕生　技術サポート＆アセンブリも国内に

ミレニアムや 2000 年問題も冷めやらぬ 2000 年 12 月、ネクスコム・ジャパンは、東京の銀座 8 丁目に事務所を構え創業を開始しました。

当初は台湾本社からの手伝いも含め、すべて台湾人で構成されていました。IT バブルがはじけた直後の厳しい船出でしたが、商品ラインナップが少ないことが幸いし、当時から技術サポートやアセンブリも国内で行っていました。

小型 SOHO 向け
EBS1563（2001 年）

2001　日本初のブレードサーバ販売

ボードメーカーとしてビジネスをスタートした 2001 年当時の主力商品は、Pentium II / IIIを搭載した PICMG ボードや、Dual CPU 搭載の ATX マザーボードでした。
初めてのネットワーク機器としては、小型 SOHO 向け EBS1563（Intel LAN x3 + VIA C3 CPU）を世に送り出し、大きな成果をあげました。同年には、ブレードサーバ Hi-Server309（3U x 9 ブレード）も発売（後に NEX Blade に名称変更）しています。

ブレードサーバ
Hi-Server309（2001 年）

2002　ネットワークの NEXCOM JAPAN

Hi-Server318（3U x 18 ブレード）や、Pentium4 を搭載した初の 19 インチラックマウント型 NSA1035 を発売し、当時 NEXCOM はネットワーク機器メーカーとしての認知度の方が高かったかと思います。

NSA1035（2002 年）

2002　初のファンレス PC をリリース

5 インチボードを内蔵した初のファンレス PC、EBS FL 366 をリリースしました。

2003　NISE シリーズ第一号をリリース

NICE3100（後に NISE3100 に名称変更）をリリースしました。NEXCOM の主力産業用ファンレス PC シリーズ、NISE シリーズの始まりです。

NISE の前身
EBS FL 366（2002年）

NISE シリーズ第一号
NICE3100（2003 年）

2009　ミラクル・リナックス x NEXCOM　統合監視サーバ

ミラクル・リナックス社（現サイバートラスト社）製の、エンタープライズ用途に特化した Zabbix ベースの統合システム監視ソリューションを、NEXCOM のハードウェアにプリインストールした統合監視サーバを発表、2013 年には ZBX3200 / ZBX6200 も販売しています。

2010　港区に移転　アセンブリ＆ストックルーム充実に

現在の東京港区芝への移転を機に、アセンブリやストックルーム等の環境を整備し、安定して商品をご提供し続けることが可能となりました。

MIRACLE ZBX® Zabbix 対応
統合監視サーバ ZBX2000（2009 年）

2012　NTT ドコモ x NEXCOM　3G/LTE ソリューションセミナ

NTT ドコモ社のセミナルームで、3G/LTE ソリューションセミナ with NTT ドコモを開催しました。今では当たり前になっている通信機能搭載 PC ですが、当時は LTE (4G) 通信回線サービスが始まったばかりのころで、画期的なシステムで多くのお客様に来場いただきました。

2014　ジャパン・パートナー・カンファレンス（JPC）in 東京

代理店様とお客様をお招きし、シャングリラ東京ホテルで開催しました。Intel 社や Microsoft 社のスピーカーにも登壇いただき、3 つの会場でセミナを行い、ディナーパーティも併せて催しました。また、前年の 2013 年には、代理店の皆様をお招きして第一回 JPC を開催しています。

2015　ジャパン・パートナー・カンファレンス 大阪 with 福西電機

福西電機社の協力のもと、大阪グランフロントの開業間もないコンターコンチネンタルホテルで、第 3 回目の JPC を開催しました。Intel 社にも登壇いただき、ディナーパーティも併せて催しました。また福西電機の優秀セールスに対しての表彰式も行いました。

2016　「組込みに Windows10 は使えるのか ?」セミナ

菱洋エレクトロ社協賛のもと、2016 年 8 月にリリースされた Windows 10 IoT Enterprise の導入メリット・デメリットを考察し、Windows10 は組込み向けとして使えるのかをテーマに、セミナを開催しました。

2016　NEXCOM Express Japan Edition 第 1 号発行

それまでの本社 NEXCOM 制作の季刊誌から、ネクスコム・ジャパン制作による刊行になりました。国内制作第一号には、NEXCOM 製 IoT クラウドソリューションパッケージの紹介や、NEXCOM の第一工場を巡るファクトリーツアーなどを掲載しました。

2017　MECHATROLINK 協会 x NEXCOM　IoT フェア in 台湾

MECHATROLINK 協会との共催で、NEXCOM 本社内の 150 人収容のオーディトリウムを使用し、台湾顧客向けに MECHATROLINK & IoT Fair を行いました。

2017　PcVue x NEXCOM　EtherCAT ベース CODESYS セミナ

CODESYS スターターキットの販売を機に、PcVue Japan 社と東京、名古屋、大阪で CODESYS セミナを実施しました。

2017　Intel x NEXCOM　製造業向け IoT カンファレンス

インテル・ジャパンと両主催での合同カンファレスでは、NEXCOM の掲げるインダストリーソリューションマップに基づき、スマートファクトリーソリューションの提案を行いました。

2020　ネクスコム・ジャパン創業 20 周年

ネクスコム・ジャパンは、2020 年 12 月 4 日に 20 周年を迎えました。

2023　NexCOBOT 自社ブース初出展　iREX 国際ロボット展

機能安全 (FuSa) 制御ソリューション搭載の協働ロボットや、NexCOBOT 製汎用ロボットコントローラと AI アプリケーションを組み合わせたロボットソリューションの展示を行いました。また、機能安全ソリューションエコシステムを形成するパートナー各社との PR イベントも開催しました。

ジャパン・パートナー・
カンファレンス（2014 年）

ジャパン・パートナー・
カンファレンス（2014 年）

NEXCOM Express
Japan Edition
第 1 号 (2016 年)

MECHATROLINK 協会 x NEXCOM
IoT フェア in 台湾（2017 年）

Intel x NEXCOM
IoT カンファレンス（2017 年）

ネクスコム・ジャパン
創業 20 周年（2020 年）

iREX 国際ロボット展
NexCOBOT ブース（2023 年）

NEXCOM Core

ネットワーク

ネットワーク＆コミュニケーションソリューションズ

- ネットワークアプライアンス / セキュリティ
- ストレージ向け DMS/ スイッチアプライアンス
- 5G 固定無線アクセス uCPE

NSAシリーズ
ネットワーク
セキュリティ
アプライアンス

DNAシリーズ
デスクトップ
アプライアンス

DFAシリーズ
5G FWA
デスクトップuCPE

DTAシリーズ
uCPE/エッジ
アプライアンス

ISAシリーズ
セキュリティ
アプライアンス

ODM
- 標準品ベース
- フルカスタム

車載 PC

モバイルコンピューティングソリューションズ

- スマート交通
- 工事関連車両
- 緊急車両
- 物流テレマティクス
- 建設・農業機械

VTCシリーズ
車載用
テレマティクスPC

ATCシリーズ
AIエッジテレマ
ティクスPC

VESシリーズ
車載用/鉄道用
PoEスイッチ

VMCシリーズ
車載用タッチパネルPC

nROKシリーズ
鉄道用
テレマティクスPC

リテール

インテリジェントプラットフォーム＆サービス

- スマートリテール
- スマートシティ
- デジタルサイネージ
- インタラクティブキオスク
- カスタマイズサービス

NDiS Bシリーズ
デジタルサイネージ用
STB

Neu-Xシリーズ
エッジコンピュー
ティングシステム

NDiS Vシリーズ
デジタルサイネージ
マルチディスプレイ

XPPCシリーズ
静電容量(P-CAP)式
ワイドタッチパネルPC

AIEdge-Xシリーズ
エッジAIコンピュータ

NEXCOM Companies

オートメーション

IoTオートメーションソリューションズ

- Industry4.0 ソリューション
- 産業用オートメーション
- インテリジェント エッジ＆ゲートウェイ
- 再生可能エネルギー向けサーバ

NISEシリーズ
産業用ファンレスPC

NIFEシリーズ
産業用ファンレスPC

TTシリーズ
オールラウンド
ファンレスPC

APPCシリーズ
産業用タッチ
パネルPC

nDASシリーズ
産業用IoTスマート
DAQソリューション

nPACシリーズ
プログラマブル
オートメーション
コントローラ

ロボティクス

ロボティクス＆モーションソリューションズ

- 産業用ロボットコントロール
- 教育用ロボット
- EtherCAT モーション＆CNC
- M2M＆クラウドサービス
- ロボット DMS・AI リテール

SCBシリーズ
機能安全
コントロールボード

RCBシリーズ
AMR専用
産業用マザーボード

NEIOシリーズ
EtherCAT I/O
モジュール

NEIO-Sシリーズ
機能安全対応
EtherCAT I/O

TPシリーズ
ティーチペンダント

IP カメラ

インテリジェントデジタルセキュリティ

- IP サーベイランスカメラ
- NVR プラットフォーム

NBRシリーズ
屋外対応
バレット型IPカメラ

NDMシリーズ
IK10/IP66 EN-50155
モバイルIPカメラ

NDRシリーズ
屋外対応
ドーム型IPカメラ

TBRシリーズ
LPR/ANPR
バレット型IPカメラ

NViSシリーズ
NVR ネットワーク
ビデオレコーダ

NEXCOMグループ ▶ ビジネスセグメントと主な取扱い製品

NEXCOM は様々な業種にわたり、グループ全体でトータルなスマートソリューションを提供しています。

EMBUX　GreenBase　TMRTEK

NEXCOM Companies

ワイヤレス

インダストリー
IoT
ネットワーキング

- 産業用ワイヤレス ソリューション
- アウトドア I4.0 システム
- ARM/MCU ODM サービス

IP カメラ（ODM）

インテリジェント
デジタル
セキュリティ

- IP サーベイランスカメラ
- NVR プラットフォーム

セキュリティ

IIoT
セキュリティ
ソリューションズ

- I4.0 セキュリティ ソリューション

AIC AIoT Cloud

NEXCOM Companies

クラウド

AIoT クラウド

- I4.0 サービス プラットフォーム
- 教育用ソリューション ＆設備

NEXCOM

NEXCOM Core

ヘルスケア

メディカル＆
ヘルスケア
インフォマティクス

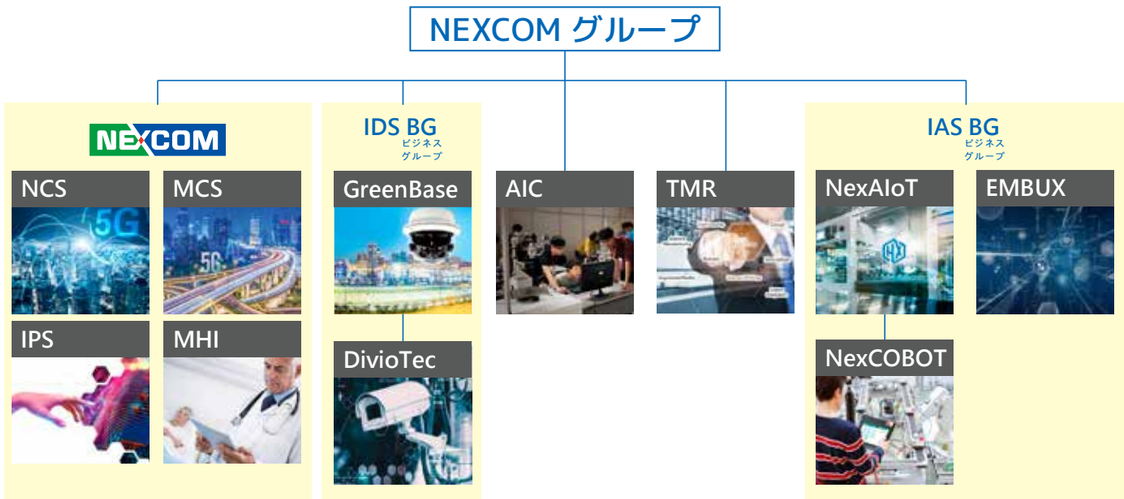
- メディカル IT システムの トータルソリューション

NEXCOM ▶ グローバルサービスネットワーク

- パートナー
- 工場
- 子会社

* 世界 50 カ国に 117 のグローバル・パートナー

NEXCOM ▶ 部門別組織図



NEXCOM JAPAN ▶ 国内向けサポートサービスとオプションサービス

Made in Taiwan こだわりの台湾製造

NEXCOM は自社工場を台湾の二か所に有し、アウトソーシングの PCB 工場も含め、CPU ボードの製造から、システムの組み立て、検査、出荷のほぼすべての業務を台湾国内で行っています。

主要部品の国内調達

PC 内部の各種主要部品（CPU / メモリ / ストレージ / Windows 等）は日本国内で調達しています。お客様のご要望に合わせた仕様で、取付けやテストを行います。国内調達することで、問題発生時にネクスコム・ジャパンが国内サポートを受けることも可能で、インテル社や日本マイクロソフト社などとも情報を共有しています。

アセンブリ＆キッティング イン東京都港区

最終出荷に近い状態でテストやソーティングを実施し、より信頼性の高い製品をお届けできるよう、社内生産を貫いています。社内でアセンブリを行うため、ご要望に合わせた仕様でシステム構築することが可能です。専用のテスト / お客様のアプリケーションのインストール / 梱包時の特別な加工 / 在庫品の管理 / エンドユーザへの直送など様々なご要望に対応しています。お客様の手間を少しでも軽減するお手伝いを致します。

ネクスコム製品は東京・港区より出荷

東京都港区芝という都心でありながら、約 24 年間一貫して国内に組み立て及び出荷業務を有し、利便性を優先、コスト以上の効果として、製品の信頼性向上を目指した環境を整えています。

修理 イン東京都港区

一次解析を含め、修理依頼品の約 9 割を国内で行っており、予備の部品などのストック専用の倉庫も有しています。

ネクスコム製品の出荷フロー

①入庫

台湾から出荷された製品は、毎週成田空港からチャータートラックで配送され、受入検査（IQC）の後、倉庫へ保管します。国内で調達したパーツ類も同様です。

②作業準備

各種パーツを事前に準備するゾーンでは、パーツの登録、データのコピー、ステッカーの準備などを行い、搭載する PC 毎に整理します。

データのコピー

③アセンブリとキッティング

台湾から届いた PC 本体と国内調達したパーツでのアセンブリを行います。起動確認後に Windows 等の設定、アプリケーションのインストールを実施します。社内サーバに保管されている作業手順書、BIOS データ、Windows イメージを読み出して作業します。

パーツの取付け

④動作試験とエージング

構成の確認を行った後に、社内標準の各種テストを実施し、数時間のバーンインテスト (負荷試験) や製品固有の試験を行います。

パネル PC の出荷前テスト

⑤出荷

各種試験をパスした PC は、外観チェック、清掃の後に、付属品と共に所定の梱包箱に収められ、日本全国に出荷されます。

長期延長保証

システムご購入の際に、費用をお支払いいただくことにより、最長 5 年間修理費用が無償になるワランティプログラムを用意しています。

貸出機のご用意

購入をご検討の方に、無償貸出しを行っています。仕様に関しては直接ご相談ください。貸出期間は通常 2 ~4 週間です。

各種認証について

製品は CE/FCC 認証、AC アダプタ等は PSE 認証を取得しています。VCCI/UL/CCC 等の認証が必要な場合は、オプションとして取得することも可能です。

NEXCOM ▶ NEXCOMの代名詞　ファンレスPCの特徴（NISE3900E）

ファンレス設計の経験・数値の双方を重要視して開発される NEXCOM のファンレス PC は、熱シミュレーションソフトウェアを使用した設計や、チャンバーによるプロトタイプの長時間テストなどの厳しい社内基準をクリアしています。その結果、NEXCOM= ファンレスというイメージが定着するほどの地位を確立するに至っています。

トップカバー　～アルミ板の削り出しと、ヒートパイプやフィンに刻まれた凸凹の溝による放熱効果～

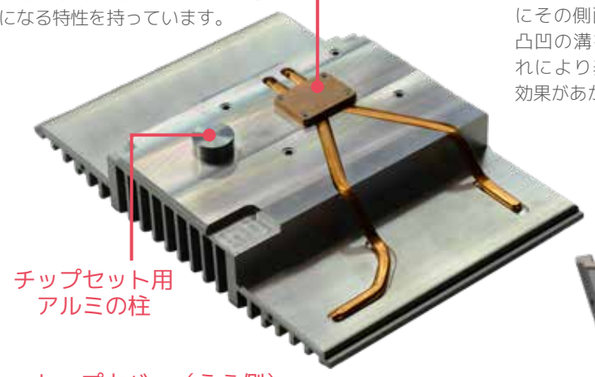
裏側は、アルミの塊とヒートパイプで、熱をトップカバー全体に行き渡らせるような構造になっています。背の高い部品の実装を避け、トップカバーをくぼませることで、ヒートパイプが直接 CPU に密着する構造にし、従来より効率を高めました。また、チップセットに密着するアルミの柱や、メモリの熱をトップカバーに伝えるための厚手のサーマルパッドも使用しています。

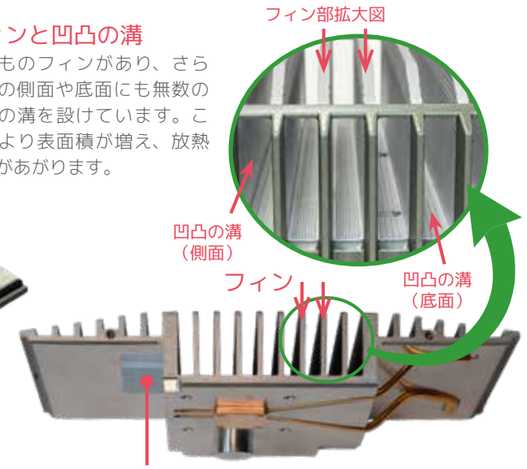
ヒートパイプ

内部の液体が移動し、熱が均等になる特性を持っています。

フィンと凹凸の溝

幾つものフィンがあり、さらにその側面や底面にも無数の凸凹の溝を設けています。これにより表面積が増え、放熱効果があがります。





トップカバー（うら側）

専用の旋盤で、1 枚ずつ丁寧に削り出します。チップセットのためのアルミの円柱は後からはめ込み、その後、アルミ板の外側に塗装を行います。

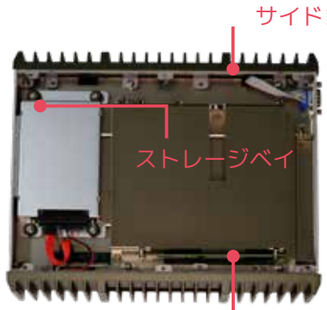
サーマルパッド

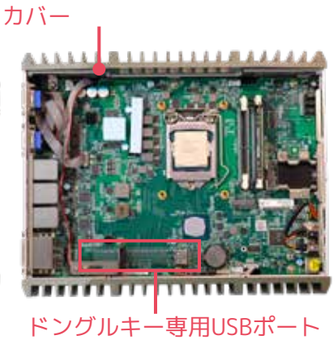
熱を反対側に効率よく引き渡すためのスポンジのようなものです。

内部　～オリジナルサイズのマザーボード～

スチール製のフレームに、マザーボード、PCI 等の拡張スロットを搭載したライザーカード、HDD や SSD 用のストレージベイがあります。マザーボードは専用に開発されたオリジナルサイズで、I/O のためのコネクタは、その殆どがオンボードで実装されています。

CPU やメモリの交換を行う際にはトップカバーを、ストレージや拡張ボードを増設する際にはボトムカバーを取り外して行います。トルクスネジを使用することで確実に締めることができ、分解をしにくくすることで、実装パーツや USB ドングルキーの盗難等を抑制します。





外観　～ケース全体が ヒートシンクとして機能～

6 面のアルミ製のカバーが、内部のスチール製のモノコックフレームに固定されています。これにより高い硬性を維持し、変形や経年による歪などを防ぎます。

各種 I/O ポートやアンテナホール、スロットなどが配置されています。

ボトムカバー

HDD 等のストレージの熱を放熱します。

サイドカバー

トップカバーや内部のフレームからの熱を放熱します。

NEXCOM ▶ NEXCOM製品の開発に必要な試験室･ラボ

本社 10 階：R&D センタ、各種テスト室

NEXCOM 本社の 10 階にある R&D センタは、先端の技術的な問題や課題を解決するセクションで、認証試験や実験・テストなどを行う、技術的に非常に重要なポジションです。新技術などのプロジェクトは、先ず R&D センタで試験を重ね、各ビジネスユニットの R&D チームに落とし込んでいきます。
そのため、R&D センタと同フロアには、EMI 電波暗室、ESD 試験室、スマートビット試験室、チャンバールーム、ロボットラボ、社内用のサーバ等の設備があります。

本社ビル各階案内

15 階　CEO 室、総務・経理、マーケティング、AIoT Cloud BU
14 階　スマートリテール BU、車載 PC BU
13 階　Green Base（監視カメラ）
　　社員食堂、スポーツジム、ヨガルーム
12 階　NexAIoT（IoT オートメーション）、
11 階　ネットワーク BU
10 階　R&D センタ、各種テスト室、ロボットラボ
9 階　受付、デモルーム、会議室、ロボット教室
　　漢台北故事館、オーディトリウム (講堂)
B2 階　各種検査ラボ

チャンバールーム

低温から高温の温度サイクルテストや湿度を上げての動作試験を行います。20 台程度の恒温槽があり、各ビジネスユニットで数台を占有しています。

ロボットラボ

様々なメーカーのロボットで、NEXCOM (NexCOBOT) のコントローラや EtherCAT 等のロボット制御アプリケーションのテストを行います。

EMI電波暗室

CE/FCC 認証の電波・電磁の試験のための事前テストであるプリスキャンを行います。

ESD試験室

電源や AC アダプタなどからは入り込むノイズやサージ試験のための試験室です。

ロボット教室(9 階)

社員の教育や、学生やお客様に NEXCOM 製ロボット教材を体験頂くロボット教室です。

地下 2 階　検査ラボ

大きな衝撃や振動を伴うような装置は、地下 2 階に設置しています。落下試験は、同じ高さの様々な角度から、梱包状態の製品を落下させます。振動試験は、XYZ の方向の輸送を想定した長時間の微振動試験や、車載用などの堅牢な PC に大きな振動を与える試験を行います。衝撃試験は、試験機のテーブルの上に商品を置き、1m 程度の高さからテーブルを落下させます。

落下試験機

振動試験装置

衝撃試験機

NEXCOM ▶ ボードからすべてをビル内工場で生産　板橋工場（第1工場）

ボードからすべてをビル内工場で生産

NEXCOM の生産拠点である新北市板橋工場は、本社から車で約 5 分、台北駅から約 20 分程度の距離に位置する 12 階建てのビルの中にあります。もともと工場として建てられたビルのため、丈夫な床、大きなエレベータ、高い天井などはオフィスビルとは異なった仕様です。

本社ビル各階案内

12 階　オフィス /PE ラボ
9~11 階　組み立てライン
8 階　DIP とテストライン
7 階　SMT ライン
6 階　受入れ（IQC）/ 倉庫
5 階　倉庫

SMT ライン

3 列の SMT ラインが 24 時間稼働し、月産約 5 万枚のボードを製造しています。

7 階　SMT ライン

チップマウンタ

X 線検査装置

DIPライン

SOP に基づきオペレータが部品の取付を行い、半田槽で半田付けをしています。

8 階　DIP ライン

半田槽

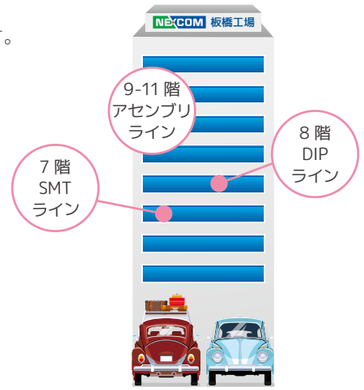
半田付け後の CPU ボードの冷却

ファンクションテストライン

ボードの起動テストや各種 I/O のテストを行っています。

初めての起動テスト

各種ケーブルを接続してのファンクションテスト
（終了後、ボードは完成）



アセンブリライン

ボードを筐体内部に取付け、BIOS の設定などを行った後、バーンインテスト、梱包作業を行っています。

9 階　組み立てライン

バーンインテスト室

箱詰めと出荷

Industry4.0 の経営判断システムを実践するスマートファクトリー

2018 年 10 月に操業を開始した NEXCOM 第 2 工場となる華亜 (ファーヤ) 工場は、台北と桃園空港の中間、工場が立ち並ぶ華亜地区にあります。工場利用を目的として建てられた 6 階建てビルの 4 階に位置し、8,300 ㎡の 1 フロアに、戦略室となるウォールーム、SMT ライン 2 本と DIP ライン 1 本を有したボード生産ライン、アセンブリライン、バーンインテスト室、ストックルーム、RMA 部門、オフィス等が含まれ、月産ボードベースで 35,000 枚、システムベースで 22,000 台の生産をこなします。従業員は約 210 名と第 1 工場とほぼ同じながら、生産数は約 30 ～ 40% 向上しています。

ボードの初期工程を作る SMT ライン

PCB (生基板) に様々な文字列などを書き込み、クリーム半田を印刷します。部品はマウンタ 4 台で自動で取付け後、高温の半田槽で処理します。行程中の実装状態の確認は、クリーム半田の印刷、及びリフローの後に半田ペーストインスペクション (AOI) を行い、最後にベテランオペレータにより 1 枚ずつ目視確認が行われます。

X 線検査方式リール部品計数装置と自動倉庫

自動倉庫内部

DIP ラインとテスト工程

PCB（基板）の不要部分の切断、オペレータによる大きな部品の取付け後、半田槽で半田付けを行います。AOI による画像処理で NG があった場合は、自動で補修を行います。最後に、複数のオペレータで、さらに細かい補修作業とフルファンクションテストを行います。

PCB 裁断機

自動補修機

アセンブリライン(組み立て＆箱詰め工程)

オペレータにより組みあがったシステムは、自動的にバーンインテスト室へと入り、4 時間程度のバーンインテスト後に工程に戻ってきます。システムにはログファイルが残されており、その結果で合否判定を行います。完成したシステムは、自動的に組み立てられた段ボール箱に入り、パレットに積まれ、出荷されていきます。

自動バーンインテスト室

システムの梱包エリア

ウォールーム (戦略指令室)

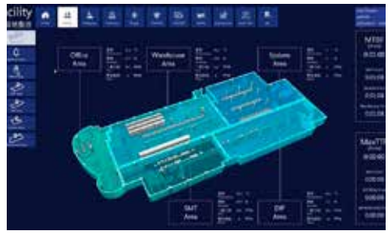
工場・顧客・商品・作業指示にかかるコストや作業時間、作業時間差・原因別による分析などの情報は、8 つのモニタを組み合わせた大型スクリーンに表示され、一括集中監視や迅速な意思決定を可能にしています。会議に参加できない遠隔地の支店や海外のメンバーも PC やタブレットで同時に情報を得ることができます。

華亜スマート工場全景

Enterprise War Room の画面を構成する 9 つのモジュール

OT	IT
-Production	-ERP/MES
-Facility	-iPDM4.0
-Energy	-Cyber Security
-Prediction	-3D Factory
-Mesh WiFi	

Production：生産ライン監視



Facility：工場設備監視

Energy：電力の見える化

Prediction：予知と保全

ERP/MES （写真は ERP 画面）

Cybersecurity：セキュリティ監視

3D Factory：3D 可視化による精密な設備監視

Mesh Wi-Fi：ネットワーク管理

iPDM4.0：生産コストのリアルタイム監視

お問合せ営業窓口

株式会社ネクスコム・ジャパン 営業部

〒108-0014　東京都港区芝 4-11-5 田町ハラビル 9 階
Tel: 03-5419-7830　FAX: 03-5419-7832
Email: sales@nexcom-jp.com　Web: www.nexcom-jp.com

台湾

台湾本社

NEXCOM International Co., Ltd.（開発・生産拠点）
9F, No.920, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C
www.nexcom.com

NexAIoT Co., Ltd.
台北事務所
13F, No.922, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C
www.nexaiot.com

NexAIoT Co., Ltd.
台中事務所
16F, No.250, Sec. 2, Chongde Rd.,
Beitun District,
Taichung City, 406, Taiwan, R.O.C
www.nexaiot.com

NexCOBOT Taiwan Co., Ltd.
13F, No.916, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C
www.nexcobot.com

GreenBase Technology Corp.
13F, No.922, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C
www.greenbase.com.tw

DivioTec Inc.
29F-1A, No.97, Sec. 4, ChongXin Rd.,
Sanchong District,
New Taipei City, 24161 Taiwan, R.O.C
www.diviotec.com

AIoT Cloud Corp.
13F, No.922, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 235015, Taiwan, R.O.C
www.aiotcloud.dev

EMBUX Technology Co., Ltd.
13F, No.916, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C
www.embux.com

TMR Technologies Co., Ltd.
13F, No.916, Chungcheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C
www.nexcom.com

中国

NEXCOM Shanghai（上海事務所）
Room 406-407, Building C, No 154, Lane 953,
Jianchuan Road, Minhang District,
Shanghai, 201108, China
www.nexcom.cn

NEXCOM サーベイランス テクノロジー（深圳）
Floor 8, Building B3, Xiufeng Industrial Zone,
GanKeng Community, Buji Street,
LongGang District,
ShenZhen, 518112, China
www.nexcom.cn

北京 NexGemo テクノロジー
Room 205, No.1, Fazhan Road.,
Beijing International Information Industry Base,
Changping District,
Beijing,102206, China
www.nexgemo.com

アメリカ

NEXCOM USA
46665 Fremont Blvd.,
Fremont, CA 94538, USA
www.nexcomusa.com

2024121500